

**Komunikat Nr 2/2018/PN**  
**Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego**  
**z dnia 12 marca 2018 r.**  
**w sprawie wycofania Polskich Norm**

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, na podstawie art. 15 ust. 2 p. 2 w zw. z art. 4 ust.9 Ustawy o normalizacji z dnia 12 września 2002 r. (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1483) ogłasza:

**Wycofanie PN-EN 62137:2007 *Badania środowiskowe i badanie trwałości – Metody badań dotyczące płytek do montażu powierzchniowego obudów typu FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON i QFN z wyprowadzeniami od spodu***

Wycofanie normy jest konsekwencją zatwierdzenia i opublikowania poprawki AP:

PN-EN 62137-4:2015-03/AP1:2018-03 *Technologia montażu podzespołów elektronicznych – Część 4: Metody badań trwałości połączeń lutowanych podzespołów do montażu powierzchniowego w obudowach z wyprowadzeniami w schemacie siatki*

przygotowanej w następstwie opublikowania przez CENELEC poprawki EN 62137-4:2014/AC:2015, korygującej błąd dotyczący braku wpisania w polu „Zastępuje” normy EN 62137:2004, która została wprowadzona do zbioru PN jako PN-EN 62137:2007.